



# 晶片級封裝

更優越的功率元件封裝：

- 雙面冷卻可提高散熱效率
- 低電感可實現更快速的開關速度
- 不用塑膠封裝，元件可以更小型化、成本更低及提高可靠性

列印此頁，  
以下就是EPC的  
FET及IC的實物原大

